# 附件二、實習訓練合作意願書

**「產業高階人才培訓計畫」**

**實習訓練合作意願書**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(合作廠商)擬與\_\_臺北醫學大學 \_ (培訓單位)合作，參加「**產業高階人才培訓計畫**」，本公司確有在職實戰訓練(on the job training)機會。提供培訓領域之人數如下說明：

|  |
| --- |
| □亞洲‧矽谷（如物聯網、智慧城市） \_\_\_\_\_\_\_人□數位經濟 \_\_\_\_\_\_\_人 □智慧機械 \_\_\_\_\_\_\_人□綠能產業 \_\_\_\_\_\_\_人 □生醫產業 \_\_\_\_\_\_\_人 □國防產業 \_\_\_\_\_\_\_人 □新農業 \_\_\_\_\_\_\_人 □循環經濟 \_\_\_\_\_\_\_人 □文創科技 \_\_\_\_\_\_\_人 □晶片設計與半導體 \_\_\_\_\_\_\_人 |

備註：

1. 合作廠商應配合編列至少每人每年九萬元，由自籌經費支應，以支付訓儲菁英各類獎金如績效獎金、結訓獎金或提早就業獎金等。**單一廠商參與本期計畫提供至多 2 名(含)實習機會。**
2. 經培訓單位與合作廠商面試後錄取之訓儲菁英，不得為合作廠商原聘僱之員工，或已與合作廠商合意將接受聘僱，再以此計畫錄取至合作廠商實習。如因上述情況不當得利或有不實情事，願負一切責任，國科會或國科會委託之機構得駁回其申請，或解除契約並召回訓儲菁英。經查核後係屬利用本計畫資源補貼合作廠商人事成本者，合作廠商未來申請本計畫將不予通過
3. 合作廠商與訓儲菁英簽訂任何合約、契約、條文前應充分讓培訓單位知曉及確認內容。

合作廠商：

計畫代表人： （簽章）

中華民國 ○ 年○ 月○ 日

**附件三、公司設立證明**